

证券代码：301348

证券简称：蓝箭电子

佛山市蓝箭电子股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-001

投资者关系活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☒ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司2024年年度网上业绩说明会的全体投资者
时间	2025年5月9日 15:00-16:00
地点	价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ）网络互动
上市公司接待人员姓名	董事长 张顺 董事、总经理 袁凤江 董事、副总经理、财务总监 赵秀珍 董事、副总经理、董事会秘书 张国光
投资者关系活动主要内容介绍	1. 从业务构成看，自有品牌和封测服务业务在 2024 年的业绩贡献变化如何，未来公司对这两项业务的战略侧重点会有怎样的调整，以提升整体业绩表现？ 答:尊敬的投资者，您好！从业绩贡献看，2024年自有品牌营业收入34,839.95万元，同比下降20.06%；封测服务营业收入35,302.14万元，同比增长21.13%。公司未来计划深化核心业务，专注增强 IC 产品工艺研发能力，积极拓展客户群体，提高在工业、汽车、新能源等市场领域的开发力度，并积极扩大海外市场份额。公司将不断通过产品升级，优化产品结构，拓宽产品应用领域，从而提升公司产品竞争力，进一步提高整体经济效益。感谢您对公司的关注！ 2. 公司的股价在一定时期内波动较大，公司如何看待股价表现与公司业绩、市场预期之间的关系，是否有计划加强与投资者的沟通和交流，提升投资

	者信心？ 答:尊敬的投资者，您好！公司管理层重视并密切关注股价情况，但股价受市场各种因素影响而波动。管理层对公司的长期发展潜力持有坚定信心，目前公司生产经营稳定，会继续发挥自身优势，夯实核心竞争力，通过不断提升管理水平和经营业绩，使投资者能够从公司长期稳定发展与业绩增长中取得合理回报。同时公司也在积极探索维护公司价值的有效途径，包括但不限于持续稳定实施分红政策等。2025年公司将继续致力于提升投资者关系管理，强化主动服务投资者的责任感，通过投资者热线电话、深交所互动易平台、现场调研、业绩说明会等多种渠道，与投资者保持紧密互动，倾听意见和建议，及时回应关注议题，促进积极互动，增强投资者信心。感谢您对公司的关注。 3. 公司的生产规模已成年产超 150 亿只半导体，目前的产能利用率是多少，未来是否有进一步扩大产能的计划，扩大产能的依据和可行性如何？ 答:尊敬的投资者，您好！公司目前产能利用率处于相对良好状态，与去年基本持平。公司通过半导体封装测试扩建的募投项目提升产能，基于目前市场需求回暖预期及前述募投项目已建设完成，公司将积极拓展工业、汽车等市场领域。公司未来将依据业务需要进一步扩大产能。感谢您对公司的关注！ 4. 公司提到推进 MES、ERP、APS、WMS 等智能制造系统建设，目前这些系统的建设进度和应用效果如何，对生产效率、产品质量和成本控制的提升作用体现在哪些方面？ 答:尊敬的投资者，您好！公司已通过MES、ERP、APS等系统实现设备互联，基本完成从订单接收到生产的智能互联，加速了核心技术产业化，提升生产效率及产品质量。系统应用可促进技术升级，降低生产成本，实现进口替代，增强竞争力。感谢您对公司的关注。 5. 公司多款车规级功率器件通过 AEC - Q101 认证，在进入汽车电子供应链方面，公司目前面临哪些挑战，如何进一步拓展在汽车电子领域的客户和市场份额？ 答:尊敬的投资者，您好！公司面临需要持续优化产品结构，拓宽产品应用领域的挑战，正通过加大车规级产品研发投入，拓展工业、汽车和新能源领域客户，并借力募投项目的扩产，提升生产规模以增强竞争力。感谢您对公司的关注！ 6. 公司在物联网、可穿戴设备、智能家居、健康护理、安防电子、新能源汽车、智能电网、5G 通信射频等领域的研发创新进展如何，预计何时能推出具有市场竞争力的新产品和解决方案？ 答:尊敬的投资者，您好！公司将聚焦上述新兴领域，持续增强在宽禁带功率半导体器件、Clip bond、LQFP及BGA封装工艺、汽车电子等领域的研发创新
--	---

	能力。公司将继续加强对车规级、氮化镓快充等产品技术研发，推出的新产品在持续进行中。感谢您对公司的关注。 7. 公司在资产运营和资本结构优化方面有哪些考虑和计划，是否有进一步的融资需求和投资计划？ 答:尊敬的投资者，您好！公司在资产运营和资本结构优化方面，均严格按照相关法律法规要求筹集资金，同时根据公司业务和生产经营情况合理制定融资计划，借力资本市场拓宽融资渠道、降低成本、优化财务结构、提高资金使用效率，实现股东利益最大化。关于公司后续的融资需求和投资计划，敬请关注公司后续披露的相关公告内容，感谢您对公司的关注。 8. 公司深化超薄芯片封装、系统级封装（SiP）、倒装焊（Flip Chip）、铜桥键合（Clip Bond）等关键工艺技术布局，这些技术目前在公司产品中的应用比例是多少，对产品性能和附加值的提升效果如何？ 答:尊敬的投资者，您好！公司已成功应用超薄芯片封装、SiP、Flip Chip、Clip Bond等技术，其中Clip Bond技术显著提升产品大电流和散热性能，Flip Chip实现更小封装尺寸和更高可靠性，SiP满足多芯片集成需求。超薄封装突破80-150 μm行业难题。目前先进封装收入占比不高，但公司正通过研发投入和技术升级持续提升其应用比例及附加值。感谢您对公司的关注。 9. 2024 年公司营业收入和净利润都下降，在市场环境和行业趋势方面，您认为哪些因素对公司这一业绩表现影响最为关键，后续这些因素会如何变化，公司有怎样的应对策略？ 答:尊敬的投资者，您好！2024年公司业绩下滑主要受全球半导体市场周期底部爬坡、消费电子需求复苏乏力、客户去库存导致市场竞争加剧及产品价格承压影响，叠加原材料及人工成本上升导致毛利率下降。后续行业预计周期性回暖，但竞争和成本压力仍存。公司将通过加大高附加值产品研发、优化产品结构、拓展客户合作及提升运营效率应对。感谢您对公司的关注。 10. 跟同行厉害的企业比，公司在半导体分立器件与集成电路封装测试业务上，优势和差距分别体现在哪？怎么提升竞争力？ 答:尊敬的投资者，您好！公司在半导体封测领域的优势体现在：1、技术优势，拥有完整的半导体封装测试技术，覆盖4-12英寸晶圆全流程封测能力；2、产品优势，在功率半导体、第三代半导体等领域产品丰富，提供多样化封装系列；3、客户优势，与美的、格力、三星、拓尔微、华润微、晶丰明源等知名企业长期合作，提供一站式服务；4、研发优势，持续投入创新，参与省市级项目并拥有多项专利；5、数字化与智能化生产体系，通过MES、ERP等系统提升效率。差距主要在于行业头部企业规模更大、先进封装技术布局更广。公司通过持续研发投入（如车规级功率器件封装、芯片级封装等技术攻关）、引进高端
--	---

	人才、提升产品性能和工艺水平、推进智能化生产体系（覆盖MES/EAP等全流程），以增强竞争力。感谢您对公司的关注。
附件清单（如有）	无
日期	2025年5月9日